

Informations de base

2013/2905(DEA)

DEA - Procédure d'acte délégué

Exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de raccordement des fils et des câbles et les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une température inférieure à – 20 °C

Complétant [2008/0240\(COD\)](#)

Subject

3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)

Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur